

3EC-III

- 于全球的标准铜箔, 我们的3EC-III type铜箔, 有着相当高的市占率。
Global standard copper foil, we have high share in the worldwide market.
- 适中的黏着面(处理面)粗糙度, 也适用于高密度的IC封装基板等。
Middle profile in the laminate side, suitable for fine pattern circuit.

用途/Application

- IC封装基板
/Semiconductor Package
- 高密度互连技术板
/High Density Interconnect
- 软性电路板
/Flexible Print Board

构成/Composition



生产地点/Production Site

- 日本/Japan
- 台湾/Taiwan
- 马来西亚/Malaysia

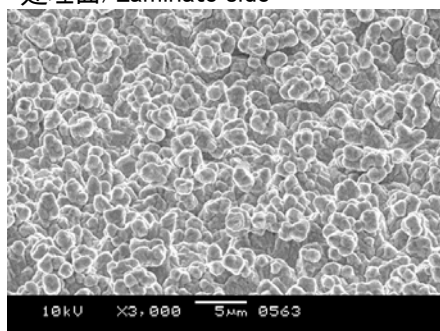
代表性特性数据/Representative data

	μm	Area weight (g/m ²)	Laminate side Rz(μm)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm)@FR-4
3EC-III	12	107	4.5	370	5	1.2
	18	153	5.0	370	8	1.4
	35	285	7.0	370	15	1.9

※上述表列为代表性数据非保证值。

This is representative data, not guaranteed.

处理面/Laminate side



阻剂面/ resist side

